

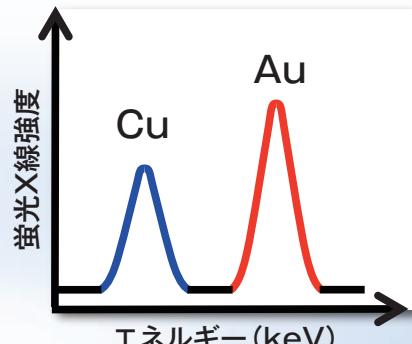
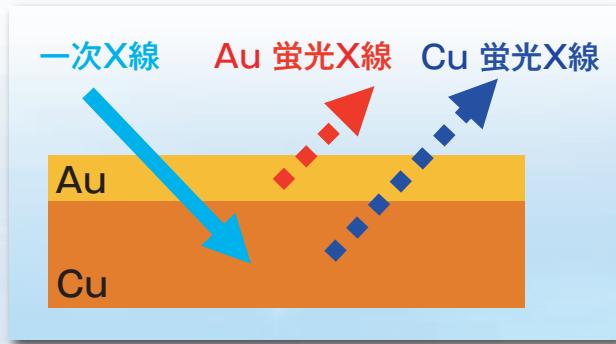
蛍光X線分析によるめっき膜厚測定の原理

Principle of thickness measurement for plating by XRF

◎ 原理



蛍光X線装置を用いためっき膜厚の測定法は、試料にX線を照射し、めっき部から放射される蛍光X線量を測定して、めっきの厚さを求める方法です。

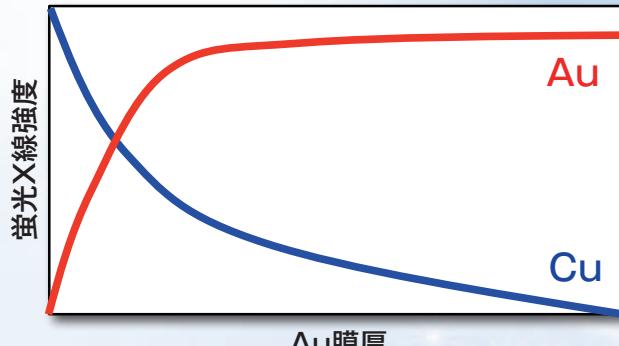


<めっき層>

膜が厚くなるとその
蛍光X線強度は増加します。

<素材(下地)>

めっき層の膜が厚くなると
素材の蛍光X強度は減少します。



◎ 特長

- 非破壊での測定が可能なため、製品検査にも活用できます。
- 多層膜を同時に測定することができる（各層が異なる元素に限る）。
- 複数点の測定が可能なため、製品面内のめっき厚みムラの評価が可能です。
- 膜厚は数nmから数十μmのレンジで膜厚を求めることが可能（元素による）。

◎ 対象機種



FT110A



FT150(シリーズ)



EA6000VX